

Im Rahmen des 2. Industrie-Partner-Symposiums (IPS) der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik fand am 6.10.2009 ein Kolloquium des IAVT und des ZµP statt. Zugleich war dies das 53. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie (VDE/VDI).

## **Agenda**

### Vorträge

#### **Lehre und Forschung für die Hetero-Systemintegration am IAVT**

Prof. Klaus-Jürgen Wolter, IAVT

#### **Nano-Röntgentomographie für Prozesskontrolle und Fehleranalyse in der Halbleiterindustrie**

Prof. Ehrenfried Zschech, Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZFP), Institutsteil Dresden

#### **Mehr Fertigungsqualität durch Statistik in der Elektronik**

Dipl.-Ing. Heiko Haupt, CeTaQ GmbH, Radeberg

#### **Effiziente Elektronikproduktion durch Einsatzsimulationsbasierter Planungstechnologien**

Dr. Dirk Hampel, simcron GmbH, Dresden

#### **Elektro-optische Leiterplatte - Ewige Zukunftstechnologie oder ernstzunehmende Alternative?**

Dr. Ralf Rieske, TU Dresden, IAVT

#### **Aufbau- und Verbindungstechnik für die Polymerelektronik**

Dr. Marco Luniak, TU Dresden, IAVT

#### **Zuverlässigkeitsbewertungen von Elektronik durch In-Situ Messverfahren**

Dr. Mike Röllig, TU Dresden, IAVT / Fraunhofer IZFP-D

### Kurzvorträge zur Posterausstellung

#### **Characterisation of Lead Free Solder Alloys at High Strain Rates Using Advanced Methods**

Hr. Dipl.-Ing. Meier, IAVT

#### **Comprehensive Material Characterization of Organic Packaging Materials**

Hr. Dipl.-Ing. Böhme, IAVT

#### **Demonstration of Board-Level Optical Link with Ceramic Optoelectronic Multi-Chip Module**

Hr. Dipl.-Ing. Nieweglowski, IAVT

#### **Influences of Sterilisation Procedures on Polymer Surfaces**

Hr. Wanke, IAVT

#### **Parylene C and Silicone as Biocompatible Protection Encapsulants for PCBs**

Fr. MSc. Beshchasna, IAVT

#### **A Novel Thermo-Mechanical Test Method of Fatigue Characterization of Real Solder Joints**

Hr. Dipl.-Ing. Metasch

#### **Voids in Lötstellen - statistische Analyse der Ursachen und deren Minimierung**

Hr. Dr. Wohlrabe, IAVT

#### **inspect inline: Hochauflösende Inspektionstechnik für die Elektronikfertigung**

Fr. Dipl.-Ökon. Oettl, IAVT